

Beschreibung

Anordnung eines elektrischen Bauelements mit einer elektrischen Isolationsfolie auf einem Substrat und Verfahren zum Herstellen der Anordnung

Die Erfindung betrifft eine Anordnung eines elektrischen Bauelements auf einem Substrat, wobei mindestens eine elektrische Isolationsfolie zur elektrischen Isolierung des Bauelements vorhanden ist und zumindest ein Teil der Isolationsfolie mit dem Bauelement und dem Substrat derart verbunden ist, dass eine durch das Bauelement und das Substrat gegebene Oberflächenkontur in einer Oberflächenkontur des Teils der Isolationsfolie abgebildet ist. Daneben wird ein Verfahren zum Herstellen dieser Anordnung angegeben.

Eine derartige Anordnung und ein Verfahren zum Herstellen dieser Anordnung sind beispielsweise aus der WO 03/030247 A2 bekannt. Das Substrat ist beispielsweise ein DCB (Direct Copper Bonding)-Substrat, das aus einer Trägerschicht aus einer Keramik besteht, an der beidseitig elektrisch leitende Schichten aus Kupfer aufgebracht sind. Auf eine dieser elektrisch leitenden Schichten aus Kupfer wird beispielsweise ein Halbleiterbauelement derart aufgelötet, dass eine vom Substrat wegweisende elektrische Kontaktfläche des Halbleiterbauelements vorhanden ist.

Auf diese Anordnung aus dem Halbleiterbauelement und dem Substrat wird eine Isolationsfolie auf Polyimid oder Epoxidbasis unter Vakuum auflaminiert, so dass die Isolationsfolie mit dem Halbleiterbauelement und dem Substrat eng anliegend verbunden ist. Die Isolationsfolie ist mit dem Halbleiterbauelement und dem Substrat form- und kraftschlüssig verbunden. Die Oberflächenkontur (Topologie), die durch das Halbleiterbauelement und das Substrat gegeben ist, wird in der Oberflächenkontur der Isolationsfolie

abgebildet. Die Isolationsfolie folgt der Oberflächenkontur des Halbleiterbauelements und des Substrats.

Die Isolationsfolie der bekannten Anordnung besteht aus einem elektrisch isolierenden Kunststoff. Zur elektrischen Kontaktierung der Kontaktfläche des Halbleiterbauelements wird in der Isolationsfolie ein Fenster geöffnet. Dadurch wird die Kontaktfläche des Halbleiterbauelements freigelegt. Nachfolgend wird auf die Kontaktfläche elektrisch leitendes Material aufgebracht.

An einer Metallisierungskante des Leistungshalbleiterbauelements oder einer Verbindungsleitung des Leistungshalbleiterbauelements kann es aufgrund der für die Ansteuerung des Leistungshalbleiterbauelements notwendigen hohen Spannungen zu einer besonders stark ausgeprägten Feldüberhöhung kommen. Aufgrund der Feldüberhöhung kann es zu einem elektrischen Überschlag kommen. Als Folge davon kann das elektrische Bauelement zerstört werden.

Zur elektrischen Isolierung von elektrischen Bauelementen werden alternativ zur aufgezeigten Laminierungstechnik auch Isolationsschichten aus einem aufgetragenen, elektrisch isolierenden Lack verwendet. Gerade an einer Metallisierungskante kann aber eine Isolationsschicht aus einem Lack ausgedünnt sein. Das Ausdünnen kann beispielsweise durch Abfließen des Lacks beim Auftragen auf die Metallisierungskante erfolgen. Durch das Ausdünnen resultierte eine verminderte Spannungsfestigkeit, der nur durch zusätzliche Maßnahmen, beispielsweise durch Auftragen einer besonders dicken Lackschicht, entgegengewirkt werden kann.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, aufzuzeigen, wie ein elektrisches Bauelement auf einem Substrat effizient gegen Feldüberhöhungen geschützt werden kann.

Zur Lösung der Aufgabe wird eine Anordnung eines elektrischen Bauelements auf einem Substrat angegeben, wobei mindestens eine elektrische Isolationsfolie zur elektrischen Isolierung
5 des Bauelements vorhanden ist und zumindest ein Teil der Isolationsfolie mit dem Bauelement und dem Substrat derart verbunden ist, dass eine durch das Bauelement und das Substrat gegebene Oberflächenkontur in einer Oberflächenkontur des Teils der Isolationsfolie abgebildet
10 ist. Die Anordnung ist dadurch gekennzeichnet, dass zumindest der Teil der Isolationsfolie mit der Oberflächenkontur eine Spannungsfestigkeit gegenüber einer elektrischen Feldstärke von mindestens 10 kV/mm aufweist.

Zur Lösung der Aufgabe wird auch ein Verfahren zum Herstellen der Anordnung mit folgenden Verfahrensschritten angegeben: a) Bereitstellen einer Anordnung mindestens eines elektrischen Bauelements auf einem Substrat und b) Auflaminieren der Isolationsfolie auf das Bauelement und das Substrat, so dass
20 die durch das Bauelement und das Substrat gegebene Oberflächenkontur in der Oberflächenkontur der Isolationsfolie abgebildet wird.

Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, dass mit Hilfe
25 einer Isolationsfolie gerade an exponierten Stellen des Bauelements, also an einer Ecke, Kante oder Spitze des Bauelements eine für den Betrieb des Bauelements notwendige Spannungsfestigkeit sicher gestellt werden kann. Die hohe Spannungsfestigkeit wird durch das Folienmaterial, die
30 Folienstärke und vor allem durch die Anbindung der Isolationsfolie an das Bauelement erreicht. Vorzugsweise wird eine hochspannungstaugliche Isolationsfolie verwendet. Unter Hochspannung ist in diesem Zusammenhang eine Spannung von mehreren hundert Volt zu verstehen. Durch das Auflaminieren
35 der Isolationsfolie wird ein fester, inniger Kontakt mit dem elektrischen Bauelement erzielt. Dies gilt auch für die exponierten Stellen des Bauelements. Es resultiert eine für

die hohe Spannungsfestigkeit notwendige innige und feste Verbindung zwischen der Isolationsfolie und dem Bauelement. Mit Hilfe der auflaminierten Isolationsfolie wird die elektrische Isolierung des Bauelements auch bei einer

5 Ansteuerspannung von mehreren hundert Volt aufrecht erhalten. Es kommt zu keinem elektrischen Überschlag.

In einer besonderen Ausgestaltung ist die elektrische Feldstärke aus dem Bereich von einschließlich 10 kV/mm bis

10 einschließlich 200 kV/mm ausgewählt. Vorzugsweise beträgt die Feldstärke mindestens 50 kV/mm. Gegenüber solchen Feldstärken ist die Isolationsfolie spannungsfest. Es kann aber auch eine Spannungsfestigkeit gegenüber höheren Feldstärken vorliegen.

15 Die hohe Spannungsfestigkeit kann entlang der gesamten Isolationsfolie vorhanden sein. Die hohe Spannungsfestigkeit ist aber insbesondere an exponierten Stellen der Isolationsfolie vorhanden. Vorzugsweise weist daher die durch das Bauelement und das Substrat gegebene Oberflächenkontur

20 mindestens eine aus der Gruppe Ecke und/oder Kante ausgewählte geometrische Form auf. Gerade an solchen Stellen des Bauelements kann es zu Feldüberhöhungen kommen. An diesen Stellen ist es daher wichtig, mit einer entsprechend angepassten Isolationsfolie und deren Anbindung an das

25 Bauelement und das Substrat für die notwendige Spannungsfestigkeit zu sorgen.

Zur Erhöhung der Spannungsfestigkeit weist in einer besonderen Ausgestaltung zumindest der Teil der

30 Isolationsfolie mit der Oberflächenkontur einen Mehrschichtaufbau auf. Durch mehrere, übereinander angeordnete Isolationsfolien wird die Spannungsfestigkeit erhöht. Dabei kann der Mehrschichtaufbau sich auch über die gesamte Isolationsfolie erstrecken. Der Mehrschichtaufbau

35 wird insbesondere durch wiederholtes Auflaminieren von einzelnen Isolationsfolien erzeugt. Insgesamt entsteht eine aus mehreren einzelnen Lagen bestehende Isolationsfolie. Die

einzelnen Lagen der mehrschichtigen Isolationsfolie können aus dem gleichen Folienmaterial bestehen. Denkbar ist aber auch, dass die einzelnen Lagen der Isolationsfolie unterschiedliche Folienmaterialien aufweisen.

5

Zumindest der Teil der Isolationsfolie mit der Oberflächenkontur weist in einer besonderen Ausgestaltung eine im Wesentlichen konstante Folienstärke aufweisen. Es tritt kein Ausdünnen der Isolationsschicht auf, wie es im Fall der Lackbeschichtung an exponierten Stellen der Fall sein kann. Eine effiziente elektrische Isolierung des Bauelements ist gewährleistet.

In einer besonderen Ausgestaltung weist zumindest der Teil der Isolationsfolie mit der Oberflächenkontur eine im Vergleich zu einem weiteren Teil der Isolationsfolie unterschiedliche Folienstärke aufweist. An den Stellen, an denen es im Betrieb des Bauelements zu Feldüberhöhungen kommen kann, wird die Isolationsfolie gezielt verstärkt. Dabei kann eine Verstärkung durch Einführen eines oben beschriebenen mehrlagigen Aufbaus erreicht werden. Die Verstärkung kann aber auch durch die Verwendung einer vorgeformten Isolationsfolie erzielt werden. In einer besonderen Ausgestaltung ist daher zumindest der Teil der Isolationsfolie mit der Oberflächenkontur vorgeformt. Die vorgeformte Isolationsfolie ist beispielsweise thermisch vorgeformt. Das Vorformen umfasst dabei insbesondere ein Vorprägen und/oder Vorstrukturieren.

Als Kunststoff der Isolationsfolie ist jeder beliebige duroplastische (duromere) und/oder thermoplastische Kunststoff denkbar. In einer besonderen Ausgestaltung weist die Isolationsfolie mindestens einen aus der Gruppe Polyacrylat, Polyimid, Polyethylen, Polyphenol, Polyetheretherketon, Polytetrafluorethylen und/oder Epoxid ausgewählten Kunststoff auf. Mischungen der Kunststoffe

und/oder Copolymerisate aus Monomeren der Kunststoffe sind ebenfalls denkbar.

In einer weiteren Ausgestaltung weist die Isolationsfolie
5 einen Verbundwerkstoff mit dem Kunststoff und mindestens
einen vom Kunststoff verschiedenen Füllstoff auf. Der
Verbundwerkstoff bildet alleine oder mit weiteren Werkstoffen
das Folienmaterial, aus dem die Isolationsfolie besteht. Bei
dem Verbundwerkstoff bildet der Kunststoff eine Matrix, in
10 die der Füllstoff eingebettet ist. Der Kunststoff ist das
Basismaterial des Verbundwerkstoffs. Der Füllstoff kann dabei
als Streckungsmittel dienen. Insbesondere wird aber der
Füllstoff zum Beeinflussen einer elektrischen und/oder
mechanischen Eigenschaft der Isolationsfolie verwendet.
15 Denkbar ist dabei insbesondere die Verwendung eines
elektrisch isolierenden und thermisch leitfähigen Füllstoffs.
Es resultiert eine elektrisch isolierende, aber thermisch
leitfähige Isolationsfolie. Durch die Verwendung einer
Isolationsfolie mit einem thermisch leitfähigen Füllstoff ist
20 es möglich, eine im Betrieb des Bauelements entstehende Wärme
vom Bauelement abzuleiten. Die thermische Leitfähigkeit
(Wärmeleitfähigkeit) λ des Füllstoffs bei Raumtemperatur
beträgt mindestens $1 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$. Um die thermische
Leitfähigkeit des Füllstoffs auszunutzen, ist ein Füllgrad
25 (Gehalt) des Füllstoffs im Kunststoff so gewählt, dass eine
Koagulationsgrenze des Füllstoffs im Basismaterial
überschritten ist. Unterhalb der Koagulationsgrenze ist eine
Wahrscheinlichkeit dafür sehr gering, dass sich die einzelne
Füllstoffpartikel berühren. Wenn die Koagulationsgrenze
30 überschritten wird, berühren sich die Füllstoffpartikel mit
relativ hoher Wahrscheinlichkeit. Daraus ergibt sich ein
relativ hoher spezifischer Wärmeleitfähigkeitskoeffizient des
Verbundwerkstoffs. Eine relativ hohe thermische Leitfähigkeit
bei gleichzeitig niedriger elektrischer Leitfähigkeit kann
35 insbesondere mit einem Füllstoff aus einem keramischen
Werkstoff erreicht werden. Ein derartiger Werkstoff ist
beispielsweise pulverförmiges Aluminiumoxid (Al_2O_3). Zur

effizienten Wärmeableitung ist die Isolationsfolie vorteilhaft mit einer Wärmesenke thermisch leitend verbunden.

Als Füllstoff ist ein beliebiger organischer oder
5 anorganischer Füllstoff denkbar. Beispielsweise ist der Füllstoff selbst ein Kunststoff. Der anorganische Füllstoff kann eine beliebige anorganische Verbindung sein, beispielsweise ein Carbonat, Oxid, Sulfid und dergleichen. Wie oben beschreiben, eignen sich anorganische Füllstoffe in
10 Form von keramischen Werkstoffen besonders. Metallorganische Verbindungen, beispielsweise siliziumorganische Verbindungen, sind als Füllstoff ebenso möglich. Denkbar ist insbesondere auch die Verwendung von verschiedenen Füllstoffen beziehungsweise die Verwendung von Füllstoffgemischen. Die
15 verschiedenen Füllstoffe können sich dabei durch ihr jeweiliges Füllstoffmaterial und/oder durch ihre jeweilige Form voneinander unterscheiden.

Der Füllstoff kann pulverförmig oder faserförmig sein. Ein
20 Durchmesser der Füllstoffpartikel beträgt einige nm bis hin zu wenigen μm . Der Durchmesser der Füllstoffpartikel ist, genauso wie das Füllstoffmaterial des Füllstoffs und ein Gehalt des Füllstoffs im Basismaterial so bemessen, dass die Isolationsfolie die hohe Spannungsfestigkeit zeigt und
25 gleichzeitig auflaminiert werden kann. Dies bedeutet, dass auch in Gegenwart des Füllstoffs eine Elastizität der Isolationsfolie erhalten bleibt, so dass die Isolationsfolie der Oberflächenkontur von Bauelement und Substrat folgen kann.

30 Vorzugsweise ist die Isolationsfolie durch Auswahl ihre Folienstärke und ihres Folienmaterials derart gestaltet, dass ein Höhenunterschied von bis zu 1000 μm überwunden werden kann. Der Höhenunterschied ist unter anderem durch die
35 Topologie des Substrats und der auf dem Substrat aufgebrachten Bauelemente gegeben. Der Höhenunterschied kann dabei durch eine oder mehrere Stufen hervorgerufen werden.

Vorzugsweise weist die durch das Bauelement und das Substrat gegebene Oberflächenkontur einen Höhenunterschied auf, der aus dem Bereich von einschließlich 200 µm bis einschließlich 1000 µm ausgewählt ist.

5

In einer besonderen Ausgestaltung liegt der Füllstoff in Form eines Geflechts vor. Bei einem Geflecht sind einzelne Fasern des Füllstoffs mit einander verwoben und/oder verflochten. Mit Hilfe des Gewebes wird sichergestellt, dass es beim
10 Auflaminieren der Isolationsfolie an exponierten Stellen des Bauelements zu keinem Ausdünnen der Isolationsfolie kommt. Damit bleibt die hohe Spannungsfestigkeit der Isolationsfolie erhalten. Gleichzeitig kann durch Verwendung eines thermisch leitenden Füllstoffs eine im Betrieb des Bauelements
15 entstehende Wärme durch Wärmeleitung über die Fasern des Gewebes effizient abgeleitet werden.

Als Bauelement ist ein beliebiges passives und/oder aktives elektrisches Bauelement denkbar. Bevorzugt wird als
20 Bauelement ein Halbleiterbauelement verwendet. Das Halbleiterbauelement ist vorzugsweise ein aus der Gruppe MOSFET, IGBT und/oder Bipolartransistor ausgewähltes Leistungshalbleiterbauelement. Für derartige Bauelemente auf einem Substrat eignet sich die oben beschriebene Anordnung
25 besonders. Mit Hilfe der Isolationsfolien kann eine effiziente elektrische Isolierung des Leistungshalbleiterbauelements und gleichzeitig eine elektrische Kontaktierung verschiedener Kontaktflächen des Leistungshalbleiterbauelements auf einfache Weise realisiert
30 werden. Darüber hinaus können weitere Funktionen in der Isolationsfolie, beispielsweise eine für den Betrieb des Leistungshalbleiterbauelements notwendige thermische Ableitung von Wärme, integriert werden.

35 Das Auflaminieren der Isolationsfolie führt zu einem innigen und festen Kontakt zwischen der Isolationsfolie und dem Bauelement und zwischen der Isolationsfolie und dem Substrat.

- Wenn die Isolationsfolie durch das Auflaminieren das Bauelement vollständig bedeckt ist, kann auf diese Weise das Bauelement hermetisch von äußeren Einflüssen abgeschirmt werden. Beispielsweise ist es so möglich, ein Vordringen von Wasser, beispielsweise von feuchter Atmosphäre, bis zum Bauelement zu unterbinden. Dies trägt zu einer verbesserten Spannungsfestigkeit der Isolationsfolie beziehungsweise der Verbindung aus Isolationsfolie und Bauelement bei.
- 10 Um den innigen Kontakt zwischen der Isolationsfolie und dem Bauelement beziehungsweise dem Substrat zu verbessern, kann vor dem Auflaminieren ein Klebstoff auf die Isolationsfolie und/oder das Bauelement beziehungsweise das Substrat aufgetragen werden. Beispielsweise wird eine Isolationsfolie mit einer Klebebeschichtung verwendet. Zur Verbesserung des Kontakts erfolgt aber in einer besonderen Ausgestaltung des Herstellverfahrens das Auflaminieren unter Vakuum. Dadurch wird ein besonders inniger und fester Kontakt zwischen der Isolationsfolie und dem Substrat und dem Bauelement erzeugt.
- 15 20 Durch das Auflaminieren unter Vakuum kann sichergestellt werden, dass die Oberflächenkontur, die durch das Substrat und das Bauelement gegeben ist, durch die Isolationsfolie nachgezeichnet wird. Die Oberflächenkontur der Isolationsfolie folgt der Oberflächenkontur des Bauelements und des Substrats. Das Auflaminieren erfolgt vorteilhaft in einer Vakuumpresse. Dazu sind Vakuumziehen, hydraulisches Vakuumpressen, Vakuumgasdruckpressen oder ähnliche Laminierverfahren denkbar. Der Druck wird vorteilhaft isostatisch aufgebracht. Das Auflaminieren erfolgt
- 25 30 beispielsweise bei Temperaturen von 100°C bis 250°C und einem Druck von 1 bar bis 10 bar. Die genauen Prozessparameter des Auflaminierens, also Druck, Temperatur, Zeit, etc. hängen unter anderem von der Oberflächenkontur des Substrats, des Folienmaterials der Isolationsfolie und der Folienstärke der Isolationsfolie ab.
- 35

Als besonders vorteilhaft erweist sich dabei eine Folienstärke der Isolationsfolie, die aus dem Bereich von 25 µm bis 150 µm ausgewählt ist. Größere Folienstärken von bis zu 500 µm sind ebenfalls denkbar. Um eine bestimmte
5 Gesamtstärke zu erhalten, kann das Auflaminieren dünner Isolationsfolien mehrmals durchgeführt werden.

In einer besonderen Ausgestaltung wird während und/oder nach dem Auflaminieren der Isolationsfolie ein Temperschritt
10 durchgeführt. Denkbar ist beispielsweise, dass eine Isolationsfolie mit einem nicht oder nur teilweise vernetzten Kunststoff verwendet wird. Durch Temperaturerhöhung wird die Vernetzung des Kunststoffs vorangetrieben. Durch die weitere Vernetzung des Kunststoffs wird der innige Kontakt zwischen
15 der Isolationsfolie und dem Substrat und dem Bauelement erzeugt. Denkbar ist neben der fortgesetzten Polymerisierung durch Temperaturerhöhung eine fortgesetzte Polymerisierung durch Belichtung.

Zur Verbesserung der Haftung der Isolationsfolie auf dem Bauelement und auf dem Substrat kann vor dem Auflaminieren eine Haftvermittlungsschicht auf der Isolationsfolie und/oder auf dem Bauelement bzw. auf dem Substrat aufgetragen werden. Denkbar ist dabei ein beliebiger ein- oder mehrkomponentiger
25 Klebstoff. Besonders vorteilhaft erweist sich eine Haftvermittlungsschicht mit einem Polysilan. Durch die Haftvermittlungsschicht wird nicht nur ein form- und kraftschlüssiger, sondern zusätzlich ein stoffschlüssiger Kontakt hergestellt. Es resultiert ebenfalls eine verbesserte
30 Spannungsfestigkeit.

Zusammenfassend ergeben sich mit der Erfindung folgende besonderen Vorteile:

35 - Durch die elektrische Isolierung des Bauelements der Anordnung mit Hilfe einer auflaminierten elektrischen

Isolationsfolie mit hoher Spannungsfestigkeit resultiert ein Aufbau, der für Hochspannungsanwendungen geeignet ist.

- Insbesondere ist dabei eine effiziente elektrische Isolierung im Bereich von exponierten Stellen des Bauelements möglich, so dass es trotz Feldüberhöhung zu keinem elektrischen Überschlag kommt.
 - Durch einfache Maßnahmen, beispielsweise durch die Verwendung geeigneter Füllstoffe, die Verwendung einer vorgeformten Isolationsfolie und/oder die Verwendung einer mehrlagigen Isolationsfolie kann die Spannungsfestigkeit der Isolationsfolie gezielt erhöht werden.
- Anhand mehrerer Ausführungsbeispiele und der dazugehörigen Figuren wird die Erfindung im Folgenden näher beschrieben. Die Figuren sind schematisch und stellen keine maßstabsgetreuen Abbildungen dar.
- Figuren 1 bis 3 zeigen jeweils einen Ausschnitt einer Anordnung eines elektrischen Bauelements auf einem Substrat in einem seitlichen Querschnitt.
- Die Anordnung 1 weist ein elektrisches Bauelement 3 auf einem Substrat 2 auf. Das Substrat 2 ist ein DCB-Substrat mit einer Trägerschicht 21 aus einer Keramik und einer auf der Trägerschicht 21 aufgetragenen elektrisch leitenden Schicht aus Kupfer.
- Das elektrische Bauelement 3 ist ein Leistungshalbleiterbauelement 32 in Form eines MOSFETs. Das Leistungshalbleiterbauelement 32 ist auf der elektrisch leitenden Schicht 22 aus Kupfer derart aufgelötet, dass eine Kontaktfläche 31 des Leistungshalbleiterbauelements 32 vom Substrat 2 abgewandt ist. Über die Kontaktfläche 31 ist einer der Kontakte des Leistungshalbleiterbauelements 32 (Source, Gate, Drain) elektrisch kontaktiert.

Zur elektrischen Kontaktierung der Kontaktfläche 31 des Leistungshalbleiterbauelements 32 ist eine Verbindungsleitung 4 auf dem Substrat 2 vorhanden.

5

Auf dem Substrat 2 und dem Leistungshalbleiterbauelement 32 ist eine etwa 50 µm dicke Isolationsfolie 5 aus einem Verbundwerkstoff derart auflaminiert, dass die Oberflächenkontur 11, die sich aus dem

10

Leistungshalbleiterbauelement 32, der elektrisch leitenden Schicht 22 und der Trägerschicht 21 des DCB-Substrats ergibt, in der Oberflächenkontur 51 eines Teils 52 der Isolationsfolie 5 abgebildet wird. Die Oberflächenkontur 11 weist einen Höhenunterschied 12 von etwa 500 µm auf.

15

Zum Herstellen der Schaltungsanordnung 1 wird das Leistungshalbleiterbauelement 32 derart auf der elektrisch leitenden Schicht 22 des DCB-Substrats 2 aufgelötet, dass die Kontaktfläche 31 des Leistungshalbleiterbauelements 32 dem Substrat 2 abgewandt ist.

20

Im Weiteren wird die Isolationsfolie 5 auf der Kontaktfläche 31 des Halbleiterbauelements 32 und dem Substrat 2 unter Vakuum auflaminiert. Dabei entsteht eine innige Verbindung

25

zwischen der Isolationsfolie 5 und dem

Leistungshalbleiterbauelement 32 bzw. dem Substrat 2. Es entsteht ein form- und kraftschlüssiger Kontakt zwischen der Isolationsfolie 5 und dem Bauelement 32 bzw. dem Substrat 2. Die Isolationsfolie 5 verbindet sich mit dem

30

Leistungshalbleiterbauelement 32 und dem Substrat 2 derart, dass die Oberflächenkontur 11, die im Wesentlichen durch die Form des Leistungshalbleiterbauelements 3 gegeben ist, durch die Oberflächenkontur 51 der Isolationsfolie 5 nachgezeichnet wird.

35

Die Isolationsfolie 5 ist eine hochspannungstaugliche Isolationsfolie. Die Isolationsfolie 5 weist eine

13

Spannungsfestigkeit gegenüber einer Feldstärke von bis zu 50 kV/mm auf. Durch das Auflaminieren der Isolationsfolie 5 ist diese hohe Spannungsfestigkeit auch in dem Teilbereich gewährleistet, in dem sich eine Ecke 33 oder Kante 34 des Bauelements 3 befindet. An diesen Stellen kommt es bei der Ansteuerung des Leistungshalbleiterbauelements 32 zu extremen Feldüberhöhungen.

Beispiel 1:

10

Die Isolationsfolie 5 ist einlagig (Figur 1). Die Isolationsfolie 5 besteht dabei aus einem Verbundwerkstoff. Das Basismaterial des Verbundwerkstoffs ist ein Kunststoff aus Polyimid. In dem Kunststoff ist pulverförmiges Aluminiumoxid als Füllstoff enthalten. Partikelgröße und Füllgrad des Aluminiumoxids sind dabei so gewählt, dass die Koagulationsgrenze überschritten ist. Aufgrund der Wärmeleitfähigkeit des Aluminiumoxids liegt eine Isolationsfolie 5 vor, die nicht nur der elektrischen Isolierung dient. Über die Isolationsfolie 5 kann Wärme, die im Betrieb des Leistungshalbleiterbauelements 32 entsteht, an eine nicht dargestellte Wärmesenke effizient abgeleitet werden.

25 Beispiel 2:

Die Isolationsfolie 5 weist ebenfalls einen Verbundwerkstoff auf. Das Basismaterial des Verbundwerkstoffs ist ebenfalls ein Polyimid. Im Unterschied zum vorangegangenen Beispiel ist der Füllstoff des Verbundwerkstoffs ein Geflecht aus Polytetrafluorethylen-Fasern. Durch das Geflecht wird die Wahrscheinlichkeit für das Ausdünnen der Isolationsfolie beim Auflaminieren erniedrigt. Es resultiert eine effiziente elektrische Isolierung des Bauelements 32.

35

Beispiel 3:

14

- Im Unterschied zu den vorangegangenen Beispielen ist der Teil 52 der Isolationsfolie 5 mit der Oberflächenkontur 51 verstärkt. Dieser Teil 52 befindet sich in dem Bereich des elektrischen Bauelements 3, in dem es aufgrund der
- 5 geometrischen Form des Bauelements 3 zu einer Feldüberhöhung durch elektrische Ansteuerung mit hohen Spannungen kommen kann. Dies führt zu einer verbesserten Durchschlagfestigkeit im Bereich des Teils 52 der Isolationsfolie 5.
- 10 Um die Verstärkung zu erzielen, wird eine vorgeformte Isolationsfolie 5 auflaminiert (Figur 2). Die vorgeformte Isolationsfolie 5 weist einen Teil 52 mit einer von einem weiteren Teil 53 der Isolationsfolie 5 abweichenden
- 15 Folienstärke auf. Die Folienstärken des Teils 52 und des weiteren Teils 53 der Isolationsfolie 5 sind unterschiedlich. Der Teil 52 der Isolationsfolie 5, durch den die Ecken 33 und Kanten 34 des Bauelements 3 elektrisch isoliert werden, weist eine höhere Folienstärke auf als der weitere Teil 53 der Isolationsfolie 5, durch den eine Isolierung der elektrischen
- 20 Verbindungsleitung 4 erreicht wird, bei der die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Feldüberhöhung niedrig ist.

Beispiel 4:

- 25 Um eine Verstärkung des Teils 51 der Isolationsfolie 5 zu erzielen, wird im Gegensatz zum vorangegangenen Beispiel eine Isolationsfolie 5 mit einem mehrlagigen Teil 52 verwendet (Figur 3). Der Teil 52 der Isolationsfolie 5 weist einen
- 30 Mehrschichtaufbau 54 auf. Die einzelnen Schichten 55 und 56 des Teils 52 der Isolationsfolie 5 bestehen aus dem gleichen Folienmaterial. Eine Gesamtfolienstärke der Isolierfolie beträgt etwa 100 μm . Zum Herstellen dieser Anordnung 1 werden zwei Isolationsfolien von jeweils etwa 50 μm nacheinander
- 35 auflaminiert, wobei als zweite Isolationsfolie eine strukturierte Isolationsfolie verwendet wird.

Patentansprüche

1. Anordnung (1) eines elektrischen Bauelements (3) auf
einem Substrat (2), wobei mindestens eine elektrische
5 Isolationsfolie (5) zur elektrischen Isolierung des
Bauelements vorhanden ist und zumindest ein Teil (52)
der Isolationsfolie (5) mit dem Bauelement (3) und dem
Substrat (2) derart verbunden ist, dass eine durch das
Bauelement (3) und das Substrat (2) gegebene
10 Oberflächenkontur (11) in einer Oberflächenkontur (51)
des Teils (52) der Isolationsfolie (5) abgebildet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest der Teil der Isolationsfolie (5) mit der
Oberflächenkontur eine Spannungsfestigkeit gegenüber
15 einer elektrischen Feldstärke von mindestens 10 kV/mm
aufweist.
2. Anordnung nach Anspruch 1, wobei die Feldstärke aus dem
Bereich von einschließlich 10 kV/mm bis einschließlich
20 200 kV/mm ausgewählt ist.
3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, wobei die durch das
Bauelement (3) und das Substrat (2) gegebene
Oberflächenkontur (11) mindestens eine aus der Gruppe
25 Ecke (33) und/oder Kante (34) ausgewählte geometrische
Form aufweist.
4. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei
zumindest der Teil (52) der Isolationsfolie (5) mit der
30 Oberflächenkontur (51) zur Erhöhung der
Spannungsfestigkeit einen Mehrschichtaufbau (54)
aufweist.
5. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei
35 zumindest der Teil (52) der Isolationsfolie (5) mit der
Oberflächenkontur (51) eine im Wesentlichen konstante
Folienstärke aufweist.

6. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei
zumindest der Teil (52) der Isolationsfolie (5) mit der
Oberflächenkontur (51) eine im Vergleich zu einem
5 weiteren Teil (53) der Isolationsfolie (5)
unterschiedliche Folienstärke aufweist.
7. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei
zumindest der Teil (52) der Isolationsfolie (5) mit der
10 Oberflächenkontur (51) vorgeformt ist.
8. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei die
Isolationsfolie (5) mindestens einen aus der Gruppe
Polyacrylat, Polyimid, Polyethylen, Polyphenol,
15 Polyetheretherketon, Polytetrafluorethylen und/oder
Epoxid ausgewählten Kunststoff aufweist.
9. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei die
Isolationsfolie (5) einen Verbundwerkstoff mit dem
20 Kunststoff und mindestens einen vom Kunststoff
verschiedenen Füllstoff aufweist.
10. Anordnung nach Anspruch 9, wobei der Füllstoff in Form
eines Geflechts vorliegt.
25
11. Anordnung nach Anspruch 9 oder 10, wobei der Füllstoff
thermisch leitfähig ist.
12. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, wobei durch
30 die durch das Bauelement (3) und das Substrat (2)
gegebene Oberflächenkontur (11) einen Höhenunterschied
(12) aufweist, der aus dem Bereich von einschließlich
200 µm bis einschließlich 1000 µm ausgewählt ist.
13. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, wobei das
35 Bauelement ein Halbleiterbauelement (32) ist.

17

14. Anordnung nach Anspruch 13, wobei das Halbleiterbauelement ein aus der Gruppe MOSFET, IGBT und/oder Bipolar-Transistor ausgewähltes Leistungshalbleiterbauelement ist.
- 5
15. Verfahren zum Herstellen einer Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 14 mit den Verfahrensschritten:
- a) Bereitstellen einer Anordnung mindestens eines elektrischen Bauelements auf einem Substrat und
- 10 b) Auflaminieren der Isolationsfolie (5) auf das Bauelement (3) und das Substrat (2), so dass die durch das Bauelement (3) und das Substrat (2) gegebene Oberflächenkontur (11) in der Oberflächenkontur (51) der Isolationsfolie (5) abgebildet wird.
- 15
16. Verfahren nach Anspruch 15, wobei das Auflaminieren der Isolationsfolie (5) unter Vakuum erfolgt.
- 20
17. Verfahren nach Anspruch 15 oder 16, wobei während und/oder nach dem Auflaminieren der Isolationsfolie (5) ein Tempersschritt durchgeführt wird.

1/1

FIG 1

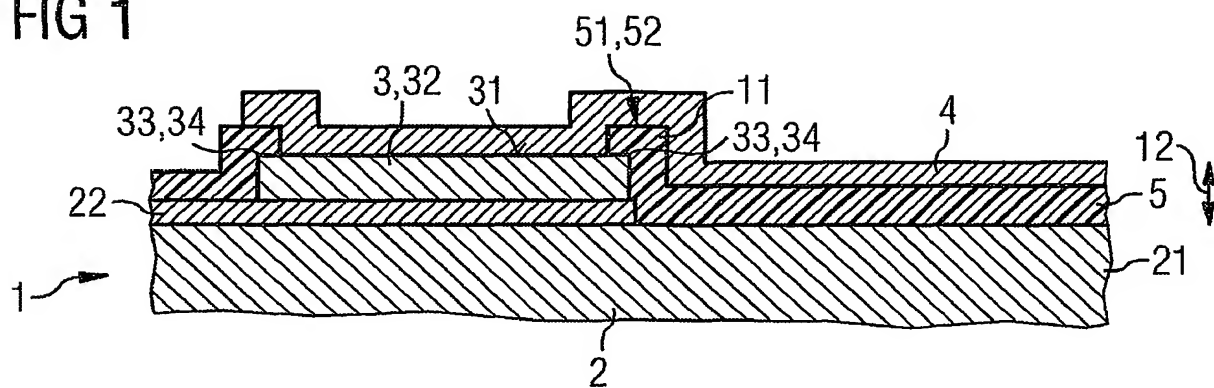


FIG 2

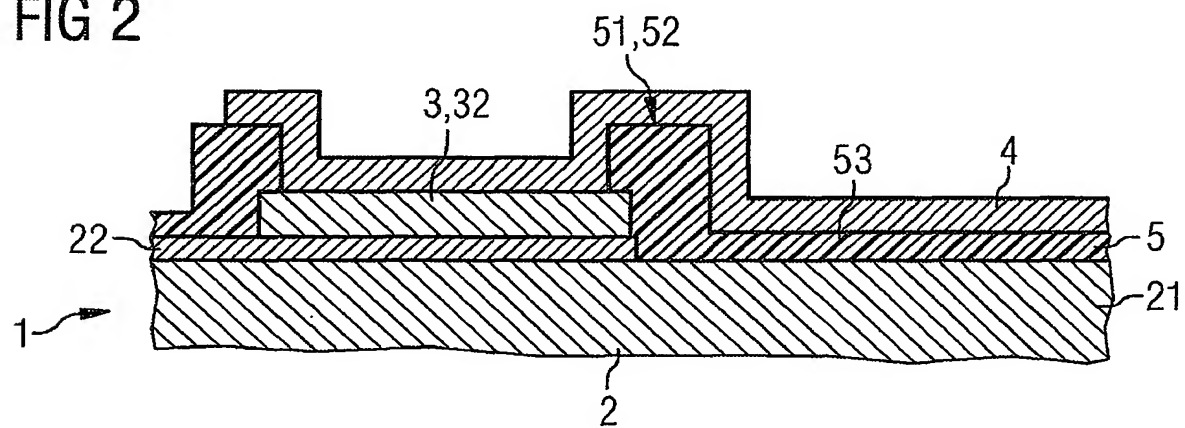
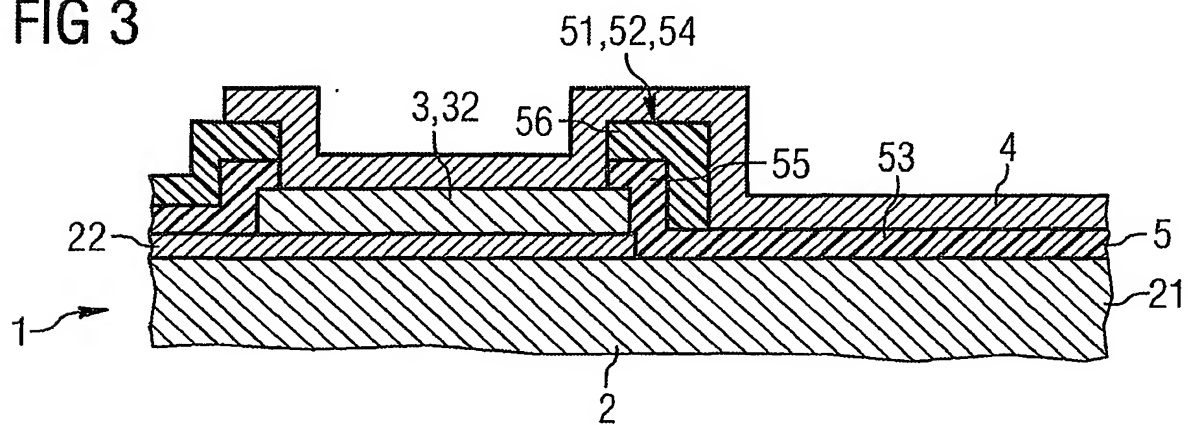


FIG 3



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP2004/051979

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 H01L23/538 H01L25/07 H01L23/498 H01L23/31

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 H01L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 03/030247 A (SIEMENS AKTIENGESSELLSCHAFT; HAESE, KERSTIN; AMIGUES, LAURENCE; SCHWARZ) 10 April 2003 (2003-04-10) cited in the application page 9, line 30 - page 13, line 20; figure 2	1-17
A	GB 1 403 786 A (PHILIPS ELECTRONIC ASSOCIATED INDUSTRIES LTD) 28 August 1975 (1975-08-28) page 2, line 56 - line 110; figure 1	1-17
A	US 3 846 825 A (BUDDE H, NL) 5 November 1974 (1974-11-05) column 3, line 6 - line 51; figure 2	1-17



Further documents are listed in the continuation of box C.



Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

30 September 2005

Date of mailing of the international search report

26/10/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Stirn, J-P

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP2004/051979

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 03030247	A	10-04-2003	CN 1575511 A	02-02-2005
			EP 1430524 A2	23-06-2004
			JP 2005515616 T	26-05-2005
			US 2005032347 A1	10-02-2005
GB 1403786	A	28-08-1975	AU 474165 B2	15-07-1976
			AU 4752572 A	26-04-1974
			CA 964382 A1	11-03-1975
			CH 545006 A	30-11-1973
			DE 2249730 A1	19-04-1973
			FR 2156343 A1	25-05-1973
			IT 968868 B	20-03-1974
			JP 48047275 A	05-07-1973
			JP 53029273 B	19-08-1978
			NL 7114112 A	17-04-1973
			SE 378706 B	08-09-1975
US 3846825	A	05-11-1974	NONE	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/051979

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 H01L23/538 H01L25/07 H01L23/498 H01L23/31

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 H01L

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	WO 03/030247 A (SIEMENS AKTIENGESellschaft; HAESE, KERSTIN; AMIGUES, LAURENCE; SCHWARZ) 10. April 2003 (2003-04-10) in der Anmeldung erwähnt Seite 9, Zeile 30 - Seite 13, Zeile 20; Abbildung 2	1-17
A	GB 1 403 786 A (PHILIPS ELECTRONIC ASSOCIATED INDUSTRIES LTD) 28. August 1975 (1975-08-28) Seite 2, Zeile 56 - Zeile 110; Abbildung 1	1-17
A	US 3 846 825 A (BUDDE H,NL) 5. November 1974 (1974-11-05) Spalte 3, Zeile 6 - Zeile 51; Abbildung 2	1-17

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

30. September 2005

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

26/10/2005

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Stirn, J-P

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/051979

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
WO 03030247	A	10-04-2003	CN	1575511 A	02-02-2005
			EP	1430524 A2	23-06-2004
			JP	2005515616 T	26-05-2005
			US	2005032347 A1	10-02-2005
GB 1403786	A	28-08-1975	AU	474165 B2	15-07-1976
			AU	4752572 A	26-04-1974
			CA	964382 A1	11-03-1975
			CH	545006 A	30-11-1973
			DE	2249730 A1	19-04-1973
			FR	2156343 A1	25-05-1973
			IT	968868 B	20-03-1974
			JP	48047275 A	05-07-1973
			JP	53029273 B	19-08-1978
			NL	7114112 A	17-04-1973
			SE	378706 B	08-09-1975
US 3846825	A	05-11-1974	KEINE		

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☒ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.